

優れた再現性 対話式タッチパネル操作



再現性の高い研磨

研磨すべてのパラメーターを策定・プログラム制御可能なため、個人差なく再現性の高い研磨ができます。

安定した荷重制御

研磨ヘッドの上下運動や加圧はすべて自動で制御されています。従来製品でよく見られた低速回転時の研磨盤ロックが解消され、低速回転時にもサンプルにダメージなく研磨することができます。精密電子バルブの採用により、100gからの正確な荷重コントロールが可能です。

ユーザーフレンドリーなオペレーション

タッチパネルオペレーションで、消耗品の交換を行うのみの作業です。

速度制御

研磨開始時に研磨速度に徐々に速度を上げていく機能を搭載。急激な加速によるサンプルへの傷を防止できます。回転速度は1rpmから制御可能です。

最大6個のサンプルを同時処理

ホルダー選択によって、サンプルを同時研磨可能です。

スムーズなオペレーションをアシスト

簡単に着脱が可能 ボウル

研磨盤下のボウル部分は簡単に着脱でき、クリーニングも簡単です。耐腐食性で、長くご使用いただけます。



ムラのないスムーズな回転 ハイトルク駆動モーター

周波数コントロールにより、トルクが強力で回転にむらがありません。また新開発Vベルト採用により、空転のないスムーズな駆動方式です。本体は機械的に接合された強固なフレームで振動もほとんどありません。

Distritech 5 自動ディスペンサー

500ccのスラリーボトルを5本取り付け、MECATECH234本体のサイドに備え付けます。研磨スラリーをMECATECH234本体よりそれぞれ適量を供給するコントロールが可能です。(※オプション)



3種類のポリッシングヘッドを選定

個別加圧装置

試料1つ1つに荷重がかかります。



均等加圧装置

ホルダー中央軸に荷重がかかります。



個別均等加圧装置

TI 10、TC 10の両方の機能を備えています。



液晶タッチディスプレイ



R & Dモード

お使いになる方が自由に各種パラメーターを調節することができます。条件策定の際には、まずこのモードで策定します。

プログラムモード

プログラムされたプロセスを用いて研磨できます。

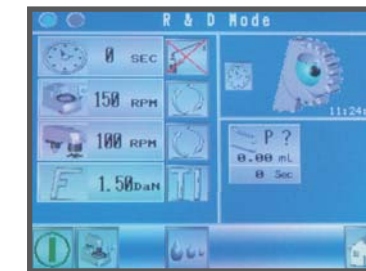
プログラムコントロール

個々のサンプルに対して策定した研磨条件をお客様ご自身でプログラムすることができます。

R & Dモード — 研磨サンプルの条件策定に

各種研磨番手における条件を任意に決めて研磨することができます。

研磨時間、研磨盤回転速度、研磨盤回転方向、サンプルホルダー回転速度、サンプルホルダー方向、加圧、ルブリカント滴下間隔、ルブリカント滴下量すべての研磨パラメーターを調整することができます。



プログラムモード — 研磨初心者でも簡単オペレーション

インストールされたサンプルのプログラムをタッチパネルで選択します。アイマークで各種ステップを予め確認することができます。すべてのパラメーターが制御されているので、個人差を最小限に抑えます。



プログラムコントロール — 研磨プロトコルをメモリー

プログラムの入力の前にパスワードを入力。メモリーはパスワードにより保護されています。

研磨時間、研磨盤回転速度、研磨盤回転方向、サンプルホルダー回転速度、サンプルホルダー方向、加圧、ルブリカント滴下間隔、ルブリカント滴下量すべての研磨パラメーターをプログラムできます。

